



Tagesordnung

Thema:	63. Treffen des Arbeitskreises „Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und Verbindungstechnologien“
Schwerpunkt:	Mess- und Prüfverfahren für die Zuverlässigkeit
Datum:	Montag, 04. Juni 2018, 10.00 Uhr
Ort:	Messezentrum NCC-Ost Raum Oslo Nürnberg
Teilnehmer:	AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Frühzeitige Erkennung von Defekten in elektrisch leitfähigen Strukturen
Herr Krüger, First Sensor AG, Berlin
- 3 10:50 Uhr
Thermografie als Prüfverfahren in der Elektronikproduktion
Herr Dr. Schaulin, TU Dresden, Dresden
- 4 11:30 Uhr
Langzeitlagerung als Bestandteil einer vorausschauenden Obsoleszenzstrategie
– Risiken und Lösungen
Herr Kuhn, HTV Halbeiter-Test & Vertriebs-GmbH, Bensheim

- 5 12:10 Uhr
Mittagessen
- 6 13:10 Uhr
Geräteintegrierter Brandschutz durch Löschsicherung
Herr Eichhorn, JOB Thermobulbs GmbH, Ahrensburg
- 7 13:50 Uhr
Messtechnik für thermische Charakterisierung auf Material-, Komponenten-
und Package-Ebene
Herr Abo Ras, Nanotest GmbH, Berlin
- 8 14:30 Uhr
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr
Automobil-Elektronik in feuchter Umgebung: Nutzen von SIR-Tests basierend
auf der IPC-9202
Herr Dr. Henneken, Robert Bosch GmbH, Stuttgart
- 10 15:40 Uhr
Modellierung, Messung und Analyse von einzelnen und gekoppelten Signalvias
in mehrlagigen HF-Substraten
Herr Perlwitz, Fraunhofer IZM, Berlin
- 11 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr